

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 研磨パッド上に粗大粒子が排出されることを防止しつつ、基板を研磨する研磨方法が開示される。フィルタを通過させた研磨液を研磨パッド上に供給しながら、基板と研磨パッドとを摺接させて、該基板を研磨する研磨方法において、研磨液の流量および圧力のうちのいずれか一方である研磨液の物理量が所定の設定値に達するまで物理量を増加させながら、フィルタに研磨液を通過させ、フィルタを
- 10 通過した研磨液を研磨パッド上に供給しながら研磨パッド上で基板Wを研磨する。

図 2